

ARAMIS TECH DAY 2019

Leading Digital Image Correlation

3Dテストにおける
技術革新とトレンド



Longitudinal Strain

epsL +40.35 %

Transversal Strain

epsL -15.77 %

3Dテストングにおける技術革新とトレンド

本会では3D面単位での変位、ひずみ計測の新たなトレンドについて、従来の測定装置であるひずみゲージや変位計と比較しながら学ぶことが出来ます。また、本会を通じ業界の専門家、各種試験担当者、各産業のスペシャリスト、研究開発者や品質保証の専門家との情報共有が出来ます。

材料試験

光学計測システムはあらゆる材料の機械的特性と挙動について、様々な試験下で分析することが出来ます。GOMのARAMISシステムは既存の試験環境、テストベンチ、マシンに統合出来ます。

- ・ 引張試験
- ・ ナカジマ試験(FLC)とバルジ試験
- ・ せん断試験
- ・ 応力、ひずみ分析

技術ノウハウ

GOMのAramisシステムは高解像度かつハイスピード3Dカメラを使用し3D座標を測定し、変位、加速度、ひずみを評価できます。また、既存の試験設備、テストベンチ、試験機へ統合出来ます。

部品試験

デジタル画像相関法(DIC)による計測とリアルタイム3Dトラッキング技術により、部品全体の静的・動的解析および疲労試験中の動的な変形解析をサポートします。

- ・ 振動分析
- ・ 自動車、航空宇宙産業における
- ・ 構造試験

イベントハイライト



プレゼンテーション – GOM社とユーザー様から2つプレゼンテーションが行われます。材料、部品試験における現在の使用方法と光学計測の利点や高度なアプリケーション紹介をいたします。



ナレッジトラック – 4つのナレッジトラックでは光学計測、デジタル画像相関法(DIC)、材料と部品試験における点単位の評価の発表が行われます。



エキスパートトーク – 6つのエリアでGOMソフトウェアの機能および日常の実践例に基づいた3D計測の新しい開発情報を提供します。



産業向けミーティングプラットフォーム – 光学計測に関する経験やGOMソフトウェアを通じて得た知見を共有するためのミーティングプラットフォームを提供します。



参加登録

ヨーロッパ

2019年9月24日 ドイツ ブラウンシュバイク

アメリカ

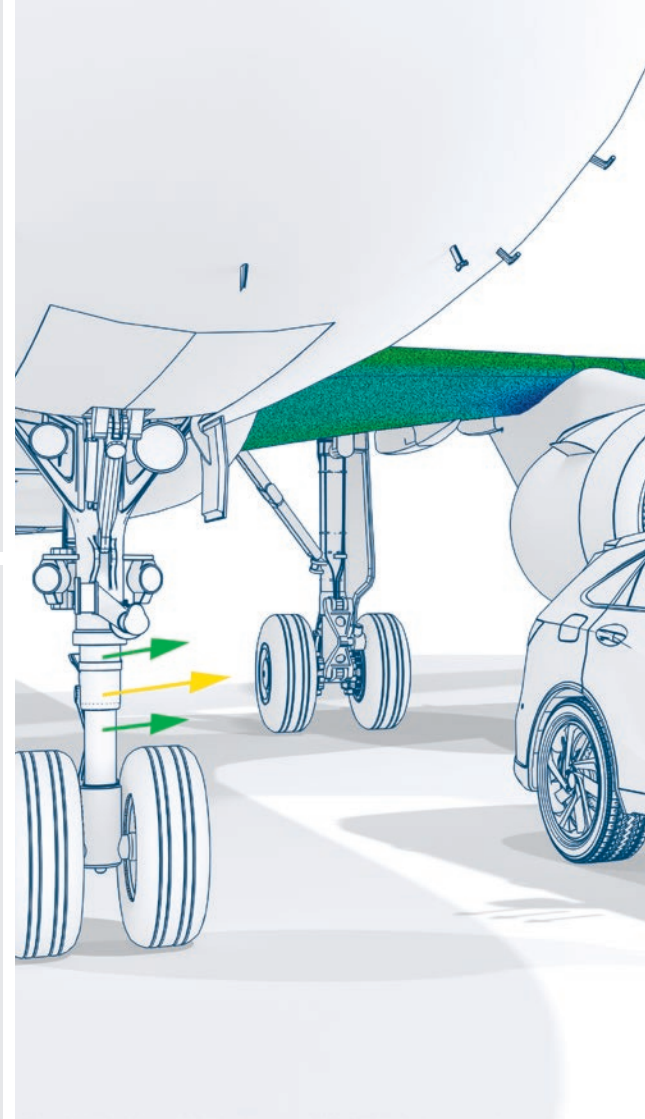
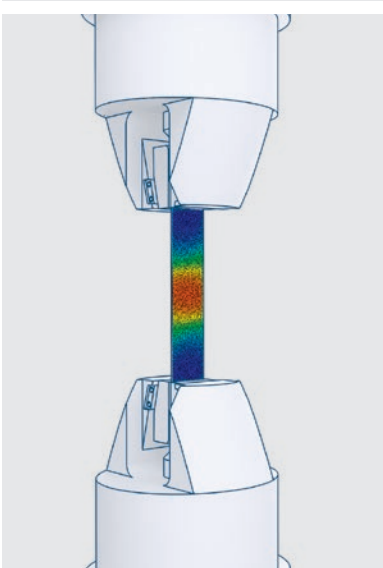
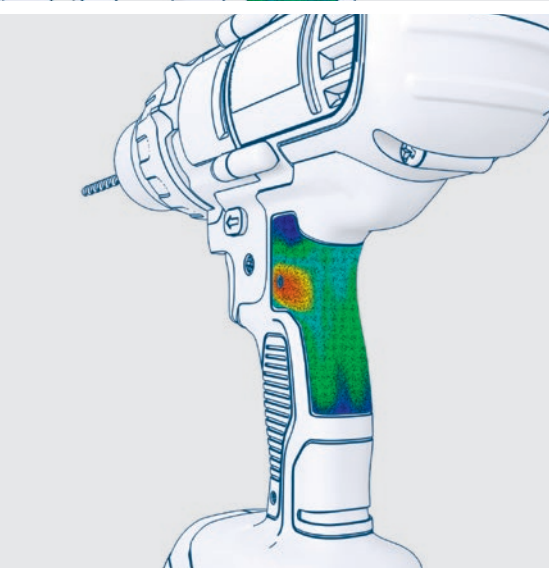
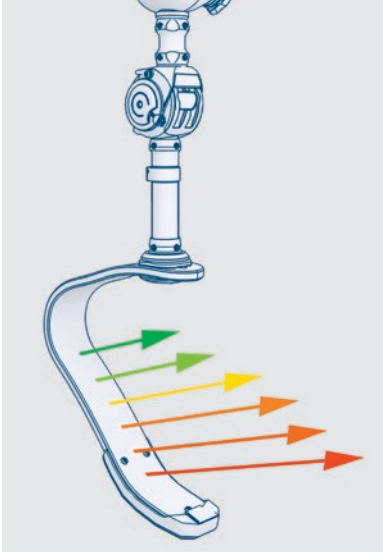
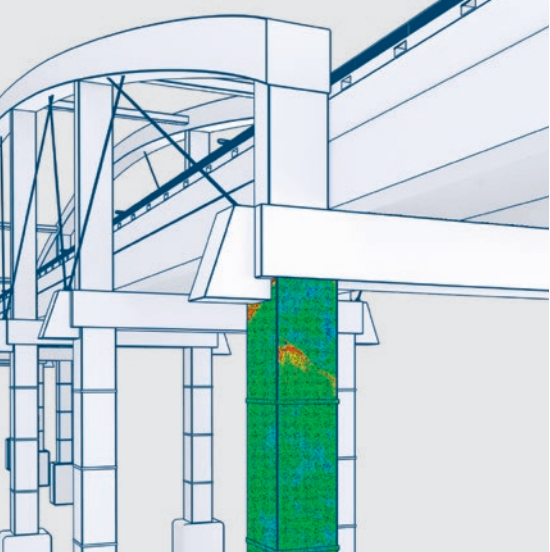
2019年10月8日 アメリカ
ペンシルベニア州 フィラデルフィア

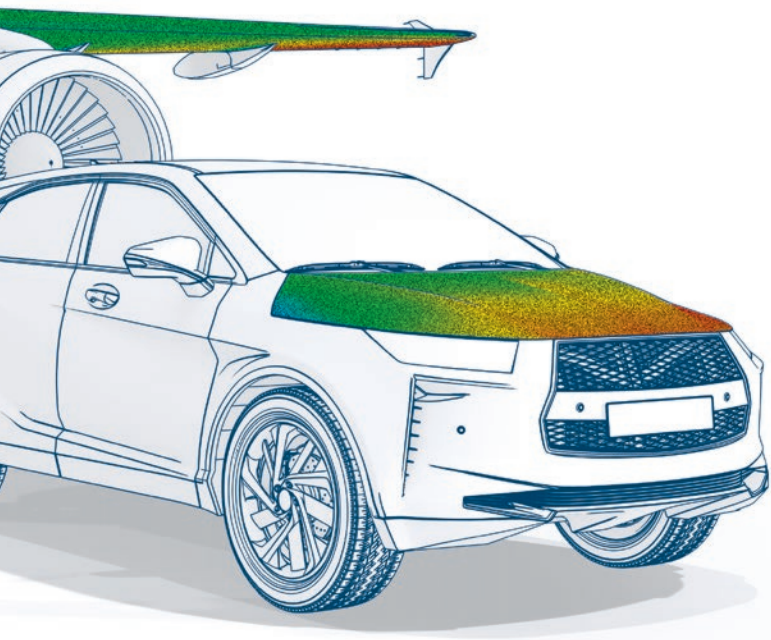
アジア

2019年11月13日 中国 上海



以下のページより
参加登録いただけます
gom.com/aramis-td





産業アプリケーション

GOMは計測センサー、評価ソフトウェアトレーニング、サポートを1社供給しています。OEM、サプライヤー、研究開発センターをサポートし製品開発サイクルを短縮し、製造コストを削減します。

自動車

航空宇宙

土木・建築

生体工学

一般消費財

研究開発

gom

www.gom.com